

信頼性 Reliability

厚膜チップサーミスタ (※標準試験規格は JIS C 2570 です。AEC-Q200 にも対応可能。)

Thick Film Chip Thermistors (※Standard test methods is JIS C 2570. AEC-Q200 is available.)

項目 Item	性能 Performances	試験条件/方法 Test Condition/Methods (JIS C 2570)	
はんだ耐熱性 Resistance to soldering heat	抵抗値変化率 Change of resistance: ≤ ±3.0% 機械的損傷のなきこと No mechanical damage.	はんだ温度 = 260 ± 5°C 浸漬時間 = 10 ± 1 秒間	Temperature of solder: 260 ± 5°C Immersion time: 10 ± 1 seconds.
はんだ付け性 Solderability	電極の 95%以上が 新はんだで 覆われていること At least 95% of termination covered with new solder	はんだ温度 = 245 ± 5°C 浸漬時間 = 3 ± 0.5 秒間 前処理 = フลักスに 1~2 秒間浸漬 フラックス = 重量比約 25%のロジン IPA はんだ = Sn-3.0Ag-0.5Cu	Temperature of solder: 245 ± 5°C Immersion time: 3 ± 0.5 seconds. Preparation: Immersion in flux for 1~2 seconds. Flux: rosin: IPA = 25wt%:75wt% Solder: Sn-3.0Ag-0.5Cu
耐基板曲げ性 Substrate bending	抵抗値変化率 Change of resistance: ≤ ±3.0% 機械的損傷のなきこと No mechanical damage.	基板たわみ量(T□T8G 以外) = 5mm (T□T8G) = 3mm 保持時間 = 10 ± 1 秒間 試験基板: ガラエポ(t=1.6mm)	Applied bending(except for T□T8G): 5mm (T□T8G): 3mm Holding time: 10 ± 1 seconds Substrate: glass fiber base epoxy resin(t=1.6mm)
耐振性 Vibration	抵抗値変化率 Change of resistance: ≤ ±3.0% 機械的損傷のなきこと No mechanical damage.	印加周波数 = (10~55~10Hz)/1 分間 印加振幅 = 全振幅 1.5mm XYZ 3 方向 印加時間 = 各方向 2 時間	Applied frequency: 10~55~10Hz / 1 minute Amplitude: 1.5mm in each X,Y,Z directions Applied time: 2 hours in each X,Y,Z directions
安定性 Stability	抵抗値変化率 Change of resistance: ≤ ±3.0% B 定数変化率 Change of B-value: ≤ ±2.0%	恒温槽 = 125 ± 3°C 保持時間 = 1000 + 48/-0 時間	Temperature: 125 ± 3°C Holding time: 1000 + 48/-0 hours
耐寒性 Low temperature	抵抗値変化率 Change of resistance: ≤ ±3.0% B 定数変化率 Change of B-value: ≤ ±2.0%	恒温槽 = -40 ± 3°C 保持時間 = 1000 + 48/-0 時間	Temperature: -40 ± 3°C Holding time: 1000 + 48/-0 hours
耐湿性 Humidity	抵抗値変化率 Change of resistance: ≤ ±3.0% B 定数変化率 Change of B-value: ≤ ±2.0%	恒温恒湿槽 = 85 ± 2°C、85 ± 5%RH 保持時間 = 1000 + 48/-0 時間	Temperature: 85 ± 2°C Humidity: 85 ± 5%RH Holding time: 1000 + 48/-0 hours
温度サイクル Temperature cycle	抵抗値変化率 Change of resistance: ≤ ±3.0% B 定数変化率 Change of B-value: ≤ ±2.0%	温度サイクル = 下記の 4 段階を連続 100 サイクル 段階 1: -40 ± 3°C 30 分間 段階 2: 室温 3 分以内 段階 3: 125 ± 3°C 30 分間 段階 4: 室温 3 分以内	Repeat the temperature cycle as below 100 times. Step 1: -40 ± 3°C 30 minutes Step 2: room temperature within 3 minutes Step 3: 125 ± 3°C 30 minutes Step 4: room temperature within 3 minutes
耐湿負荷 Load humidity	抵抗値変化率 Change of resistance: ≤ ±3.0% B 定数変化率 Change of B-value: ≤ ±2.0%	恒温恒湿槽 = 85 ± 2°C、85 ± 5%RH 印加電力 = 最大許容電力 保持時間 = 90 分印加 ~ 30 分休止 1000 + 48/-0 時間	Temperature: 85 ± 2°C Humidity: 85 ± 5% RH Applied power: Max. permissible power Holding time: 90 minutes on, 30 minutes off for 1000 + 48/-0 hours

